

电通微电

深圳电通纬创微电子股份有限公司成立于2007年2月，由电通集团在深圳投资成立的以集成电路（IC）封装测试及MEMS压力传感器研发、生产、销售为主营业务的国家高新技术企业。固定资产投资近亿元人民币，拥有全套进口的封装生产设备合计220余台，标准防静电净化厂房7000m²。拥有先进的研制、生产、试验、检验设备和优秀的管理技术团队。

2008年7月公司通过了UKAS的ISO9001质量体系认证，2013年7月审核通过国家高新技术企业认证，2016年10月顺利通过国家高新技术企业的重新认定。2014年8月“新三板”挂牌（股票代码：830976）。截止2019年3月，拥有发明专利1项、实用新型专利24项、外观专利1项，专利总数达26项；2015年10月通过TS16949质量体系认证。2015年、2018年连续通过《安全生产标准化三级企业》认证证书。

公司始终致力于提升产品的生产加工过程品质，在封装、测试设备、封装工艺、以及材料的选择上，与国际知名公司看齐，配备国际知名的相关设备；满足客户对各种不同线型的要求。IC封装产品广泛应用于LED驱动，通讯，计算机，消费类电子产品及汽车电子产品。目前公司主要封装产品类型包括SOP、SSOP、SOT、TSOT几大系列，20余种封装规格。

公司积极抓住行业新机遇，拓展MEMS压力传感器领域，引入先进封装工艺生产、增加市场热点产品产能规模。同时，公司进一步推广具有自主知识产权的MEMS传感器产品，为客户提供更好的解决方案，满足市场需求；努力提高核心技术亮点和增加高毛利产品，提高技术研发能力、产业化生产能力、及产品功能挖掘能力。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/dtwd-349083.html>

